DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

XRPX Acc No: N99-081655

Manufacturing method of organic electroluminescence element for backlight of flat LC display — involves forming various layers of element inside vacuum chamber in the absence of atmospheric air

Patent Assignee: MATSUSHITA DENKI SANGYO KK (MATU)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 10335061 A 19981218 JP 97146189 A 19970604 199910 B

Priority Applications (No Type Date): JP 97146189 A 19970604 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 10335061 A 8 H05B-033/10

Abstract (Basic): JP 10335061 A

NOVELTY - A catholyte (15), an organic thin film, a light emission layer (14) and an anodised layer (12) are laminated on a transparent substrate (11). The entire arrangement is sealed by a sealing material. The formation process is done in a vacuum chamber (1) in the of absence of atmospheric air. Chamber pressure is adjusted to a low value of 10-4, 10-6 or 10-10 torr. DETAILED DESCRIPTION - An apparatus for manufacturing the organic element is also claimed independently.

USE - For backlight of flat LC display, light source in display optical communication system.

ADVANTAGE - Since the entire process is done in the absence, absorption of moisture in the air by various layers during manufacture is avoided. Hence, degradation of element is prevented. Life of the element is increased. Bonding of sealing material with a transparent substrate further prevents the moisture absorption. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows the sectional view of the element. (11) Substrate; (12) Anodised layer; (15) Catholyte.

Dwg. 3/5

Title Terms: MANUFACTURE; METHOD; ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; ELEMENT; FLAT; LC; DISPLAY; FORMING; VARIOUS; LAYER; ELEMENT; VACUUM; CHAMBER;

ABSENCE; ATMOSPHERE; AIR

Derwent Class: U12; U14; W05; X26

International Patent Class (Main): H05B-033/10

International Patent Class (Additional): H05B-033/26

File Segment: EPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06051961 **Image available**

METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

PUB. NO.:

10-335061 [JP 10335061 A]

PUBL I SHED:

December 18, 1998 (19981218)

INVENTOR(s): KOMATSU TAKAHIRO

IWANAGA HIDEAKI

GYOTOKU AKIRA

HARA SHINTARO

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

09-146189 [JP 97146189]

FILED:

June 04, 1997 (19970604)

INTL CLASS:

[6] H05B-033/10; H05B-033/26

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 14.2 (ORGANIC

CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds): 44.2

(COMMUNICATION -- Transmission Systems)

JAPIO KEYWORD: ROO2 (LASERS); ROO3 (ELECTRON BEAM); ROO7 (ULTRASONIC WAVES);

RO11 (LIQUID CRYSTALS); RO20 (VACUUM TECHNIQUES); RO44 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R124 (CHEMISTRY --Epoxy Resins): R125 (CHEMISTRY -- Polycarbonate Resins)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL element, in which the change with the lapse of time such as growth of dark spot and lowering a of luminance is reduced so as to obtain the long lifetime, by manufacturing an organic EL element from a process for forming to a process for sealing with the sealing material without exposing the EL element with the atmospheric air.

SOLUTION: Etching is performed to a glass substrate, which is formed with an ITO film as a positive electrode layer over the whole surface, by using hydrochloric acid so as to form a positive electrode layer having the predetermined pattern. The glass substrate is washed by the ultrasonic washing using the aminebase organic compound detergent, and washed by the ultrasonic washing using pure water, and washed with the ammonium hydrogen peroxide solution, and washed with the pure water. Moisture is dried by a nitrogen blower, and finally heated for drying. This washed glass substrate 3 is set in a vacuum chamber 1, and internal pressure of the vacuum chamber 1 is lowered to a vacuum degree at 2X10-6Torr or less, and TPD is used as a deposition source 2 so as to form a hole transport layer. Continuously, Alg3 is used as a deposition source so as to form a light emitting layer. AlLi, which includes Li in the same vacuum condition, is used as a deposition source 2 so as to form a negative electrode layer of a thick film at 2000 nm.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-335061

(43) 公開日 平成10年(1998) 12月18日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H05B 33/10

33/26

H05B 33/10 33/26

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平9-146189

(71)出願人 000005821

(王0月)

(22)出願日

平成9年(1997)6月4日

4/工器四字

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 小松 隆宏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 岩永 秀明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 行徳 明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機EL素子の製造方法及びその製造装置

(57)【要約】

【課題】 外部から進入する水分や酸素が有機EL素子の信頼性を損なわせるため、この進入を防ぎ経時変化の少ない長寿命化を図った有機EL素子を提供することを目的とする。

【解決手段】本発明の有機EL素子の製造方法は、透明または半透明の基板上に積層された陽極層、有機薄膜、陰極層を有する有機EL素子の外側を封止材によって封止する有機EL素子の製造方法であって、有機EL素子の形成工程から封止材による封止工程までを大気に曝すことなく行う構成を有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】透明または半透明の基板上に積層された陰極層、有機薄膜、陽極層を有する有機EL素子の外側を封止材によって封止した有機EL素子の製造方法であって、前記有機EL素子の形成工程から封止材による封止工程までを大気に曝すことなく行うことを特徴とする有機EL素子の製造方法。

1

【請求項2】前記有機EL素子の形成工程から封止材による封止工程までを、 1×10^{-1} Torr $\sim1\times10^{-10}$ Torr好ましくは 1×10^{-4} Torr $\sim1\times10^{-6}$ Torrの減圧下で行うことを特徴とする請求項1に記載の有機EL素子の製造方法。

【請求項3】前記透明または半透明の基板と、前記封止 材の少なくとも一部分を光硬化性樹脂によって接着する 接着工程を有することを特徴とする前記請求項1又は2 に記載の有機EL素子の製造方法。

【請求項4】真空チャンパーと、前記真空チャンパーに接続された真空装置と、前記真空チャバー内に配設された有機EL素子若しくは封止剤のいずれかを搬送し前記有機EL素子と封止材を押圧する搬送押圧手段及び前記 20有機EL素子と前記封止材の間に形成された接着剤層を硬化させる硬化手段と、を有することを特徴とする有機EL素子の製造装置。

【請求項5】接着剤の前記硬化手段が紫外線照射装置であることを特徴とする前記請求項4に記載の有機EL素子の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示用ディスプレイのバックライトやディスプレイや表示・光通信の光 30 源などに用いられる電気的発光素子である有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子と略す)の製造方法及びそれに用いる製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】EL(エレクトロルミネッセンス)素子とは、固体蛍光性物質の電界発光また、エレクトロルミネッセンスといわれる現象を利用した発光デバイスであり、現在無機系材料を発光体として用いた無機EL素子が実用化され、液晶ディスプレイのバックライトやフラットディスプレイ等への応用展開が図られている。しか 40 しながら、無機EL素子は素子を発光させるために交流でしかも100V以上の高電圧が必要であること及び青色発光が難しく、R. G. B. 三原色によるフルカラー化が困難であることなどの課題を有していた。

【0003】一方、有機材料を用いたEL素子に関する研究も古くから行われていたが、低い輝度しか得られず本格的な実用化研究には至っていなかった。しかし、1987年にコダック社のC.W.Tangらにより提案された構造つまり、有機物質をホール輸送層および発光層の2層に分けた機能分離型の積層構造を有する有機E50

L素子は、10 V以下の低電圧にもかかわらず1000 c d/m 2 以上の高輝度発光を実現した。(C. W. Tang and S. A. Vanslyke: Appl. Phys. Lett、51(1987)913)それにより、有機ELが俄然注目され、近年同様の構成を有する積層型の有機EL素子についての研究が盛んに行われてきている。

【0004】次に一般的な有機EL素子構成について、以下図面を用いて説明する。図5は一般的な有機EL素子の要部断面図である。図中11は透明なガラス基板、12はガラス基板11上にスパッタリング法や真空蒸着法などを用いて形成されたITOなどの透明電極膜で正孔注入電極となる陽極層、13はTPD (N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-1,1'-ジフェニル-4,4'-ジアミン)等の正孔輸送層、14はAlq、<math>(8-Hydroxyquinoline Aluminume)等で形成された発光層、15は主にAlLi、MgAgなどの仕事関数の低い金属膜で形成された電子注入電極となる陰極層、16は防湿性物質からなる保護膜である。

【0005】以上のように構成された有機EL素子にI TO側にプラス、陰極側にマイナスの直流電圧を印加す ることで発光層内での再結合、それによる励起子の生 成、最後に励起状態から基底状態への移行によって発光 が起きる。この様な発光機構に基づく有機EL素子にお いて発光特性を向上させるには主として、a. 発光層、 正孔輸送層等の有機膜の改善、b. 陽極層、陰極層の改 善が必要となる。これらのうちb.の陰極層の改良は発 光層へ電子を入りやすくすることを目的とするため、電 子注入層または発光層との障壁を低くしなければならな い。よって、陰極層の材料としては仕事関数が小さく電 気伝導性の高いことが求められ、例えば、MgAg(米 国特許4885211号公報) やA1Li (特開平5-121172号公報) 等の合金が一般に用いられてい る。ところで、これら合金は非常に活性で化学的に不安 定である。そのため、外部からの水分や酸素によって陰 極材が腐食、酸化してしまい、発光面中に存在するダー クスポットと呼ばれる未発光部の著しい成長や、輝度低 下等の経時的劣化を生じさせ易くなる。また、有機EL 素子に使用される発光層や正孔輸送層等の有機固体は、 一般に水分、酸素に弱く、同様にダークスポットの成長 や輝度低下を招く。したがって、実用的な有機EL素子 やそれを用いたデバイスには有機材料や電極材料への水 分及び酸素の進入を防ぐ目的で素子を封止し、信頼性を 向上させなければならない。

【0006】有機EL素子の封止方法についてはこれまで様々な提案が成されてきた。例えば、無機ELにて実際に実用化されている方法、すなわち、背面電極の外側にガラス板を設け、背面電極とガラス板の間にシリコーンオイルを封入する方法や、特開平5-089959号

3

公報で開示されいる素子上に絶縁性無機化合物からなる 保護膜を設け、その外側に電気絶縁ガラスまたは電気絶 縁性気密流体からなるシールド層を設ける方法及び特願 平6-004065号公報で開示されているように、吸 水率1%以上の吸水物質と吸収率0.1%以下の防湿性 物質からなる封止材を形成するなどの方法等である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来の有機EL素子の封止方法では、真空中において有機EL素子を形成した後、いったん素子を真空チャンバーか 10 ら取り出し、改めて素子封止を行うため素子部分への水分の進入を完全に抑えることはできず、その結果、未発光部位の成長を招いてしまうという課題があった。さらに、このような素子作製工程と封止工程を分離させた方法は多大の作業工数と生産工数を要し作業性や生産性に欠けるという課題があった。また、従来の有機EL素子の製造装置では、有機EL素子基板と封止材とを接着する機能を有していないため多大の作業工数を要し作業性や生産性に欠けるという課題があった。

【0008】本発明は上記課題を解決するもので、素子形成から封止までの各工程において素子部が水分子や酸素に触れることを防止し、ダークスポットの成長、輝度の低下という経時変化の少ない、長寿命化を図った有機EL素子の製造方法を提供すること、及び真空チャンバー内で簡便に有機EL素子基板と封止材とを接着することができ有機EL素子の生産性を著しく向上できる有機EL素子の製造装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は有機EL素子の外側を封止材によって保護 30 する有機EL素子の製造方法において、前記有機EL素子の形成から封止材による封止までを大気に曝すことなく行うものである。これにより、ダークスポットの成長、輝度の低下という経時変化の少ない長寿命化を図った有機EL素子を提供することができる。

【0010】本発明の有機EL素子の製造装置は、有機EL素子あるいは封止材の少なくとも1つを搬送押圧できる機構と、接着剤硬化装置を有している。これにより、有機EL素子の製造装置内で簡便に有機EL素子基板と封止材とを接着することができ作業性や生産性を著40しく向上できる有機EL素子の製造装置を提供することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の有機E L素子の製造方法は、透明または半透明の基板上に積層 された陰極層、有機薄膜、陽極層を有する有機EL素子 の外側を封止材によって封止する有機EL素子の製造方 法であって、前記有機EL素子の形成工程から封止材に よる封止工程までの工程を大気に曝すことなく行うこと としたものであり、これによりEL素子部への水分や酸 50 素の吸着及び接触を完全に抑えることができるという作 用を有する。

【0012】本発明の請求項2に記載の有機EL素子の製造方法は、請求項1において、前記有機EL素子の形成工程から封止材による封止工程までを 1×10^{-1} Torr 0 Torr 好ましくは 1×10^{-1} Torr の減圧下で行うこととしたものであり、これによりEL素子部への水分や酸素工程の吸着及び接触を完全に抑えることができるという作用を有する。

【0013】本発明の請求項3に記載の有機EL素子の製造方法は、請求項1又は2において、前記透明または半透明の基板と前記封止材の少なくとも一部分を光硬化性樹脂によって接着する接着工程を有することとしたものであり、これにより光硬化性樹脂の高耐質性と速い硬化性により外部からの水分や酸素を完全に遮断することができるという作用を有する。

【0014】本発明の請求項4に記載の有機EL素子の製造装置は、真空チャンバーと、前記真空チャンバーに接続された真空装置と、前記真空チャバー内に配設された有機EL素子若しくは封止材のいずれかを搬送し前記有機EL素子と封止材を押圧する搬送押圧手段及び前記有機EL素子と前記封止材の間に形成された接着剤層を硬化させる硬化手段と、を有することとしたものであり、これにより、有機EL素子の製造装置内で簡便に有機EL素子基板と封止材とを接着することができるという作用を有する。

【0015】本発明の請求項5に記載の有機EL素子の製造方法は、請求項4において、前記硬化手段が紫外線照射装置であることとしたものであり、これにより、有機EL素子の製造装置内で簡便に有機EL素子基板と封止材とを接着することができるという作用を有する。

【0016】以下に本発明の実施の形態に有機EL素子の製造方法及びそれに用いる製造装置について、図面を用いて説明する。

【0017】(実施の形態1)図1は本発明の一実施の 形態における有機EL素子の製造装置の断面模式図であ り、図2は本発明の一実施の形態における有機EL素子 の断面模式図である。

【0018】図1及び図2において、1は真空チャンバー、2は蒸着源、3はガラス基板11の表面にITO等の陽極層12が形成されたITO基板、4は有機EL素子部、13は正孔輸送層、14は発光層、15は陰極層、5は保持金具、6は封止材、7は接着部、8は封止材移動機構、9は接着剤硬化装置、10は基板搬送押圧機構である。

【0019】まず、全面に陽極層12としてITO膜が形成されたガラス基板11を所定のパターン形状に陽極層12(膜厚160nm)を塩酸を用いてエッチングする。

【0020】ガラス基板11を洗剤(セミコクリーン、 フルウチ化学社製)で5分間超音波洗浄した後、純水で 10分間超音波洗浄し、さらにアンモニア過酸化水素溶 液(アンモニア水:過酸化水素溶液:水=1:1:5 (∨ 0 1 比))で5分間超音波洗浄した後、70℃の純 水で5分間超音波洗浄を行い、窒素プロアーにて水分を 飛ばし、最後に250℃の温度で加熱し乾燥させる。こ の様に洗浄したガラス基板3 aを真空チャンバー1内に セットし、真空チャンバー1の内圧を2×10-6To rr以下の真空度まで減圧した後、TPDを蒸着源2と 10 して約500nmの正孔輸送層4aを形成する。続い て、Ala3を蒸着源2として約750nmの発光層4 bを形成する。次に、同一真空下にて15at%のLi を含むA1Li合金を蒸着源2とし、2000nmの膜 厚の陰極層15を形成する。

【0021】本実施の形態における有機EL素子の構成 は特に限定されるものではなく、例えば、上記に示した 陽極層12/正孔輸送層13/発光層14/陰極層15 以外の構造、陽極層/発光層/陰極層の単層型素子や陽 極層/発光層/電子輸送層/陰極層の2層型構造及び陽 20 極層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極層の3層 構造であっても良い。さらに、本発明の有機EL素子を 構成する材料も限定するものではなく、前述した以外の 種々の材料を用いて形成することが可能である。例え ば、陽極層12の材料としてはITO膜以外に、ATO (SnO, にSbをドープ)、AZO(ZnOにAlを ドープ) 等が挙げられる。また、正孔輸送層13の材料 としては、正孔移動度が大で、成膜性が良く、透明であ る物が望ましく、例えば、特開平4-129191号公 報、特開平4-13289号公報、特開平4-2556 92号公報に記載のポルヒィン、テトラフェニルポルヒ ィン銅、フタロシアニン、銅フタロシアニン、チタニウ ムフタロシアニンオキサイド等のポリフィリン化合物、 1、1-ビス {4-(ジ-P-トリルアミノ) フェニ ル}シクロヘキサン、4、4'、4''ートリメチルト リフェニルアミン、N、N、N'N'-テトラキス (P ートリル) - P - フェニレンジアミン、1 - (N、N -ジーPートリルアミノ)ナフタレン、4、4'ービス (ジメチルアミノ) -2-2'-ジメチルトリフェニル メタン、N、N、N'、N'-テトラフェニルー4、 4'-ジアミノピフェニル、N、N'-ジフェニルー N、N'ージーmートリルー4、N、Nージフェニルー N、N'-ピス(3-メチルフェニル)-1、1'-4、4'-ジアミン、4'-ジアミノビフェニル、N-フェニルカルバゾール等の芳香族三級アミン、4-ジー **Pートリルアミノスチルベン、4-(ジーPートリルア** ミノ) -4'-[4-(ジ-P-トリルアミノ) スチリ ル] スチルベン等のスチルベン化合物、トリアゾール誘 導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、 ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラ 50 キノリン系金属錯体やジリチウムエピンドリジオン等が

ゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アニールア ミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール 誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘 導体、ヒドラゾン誘導体、シラザン誘導体、ポリシラン 系アニリン系共重合体、高分子オリゴマー、スチリルア ミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポリ3-メチルチオフェン等の化合物を用いることができる。ま たポリカーボネート等の高分子中に低分子の正孔輸送材 料を分散させた、高分子分散系の正孔輸送層も用いられ る。発光層14の材料としては、可視領域に蛍光を有 し、成膜性の良いことが求められ、例えば特開平4-2 55692号公報に記載のベンゾチアゾール系、ベンゾ イミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白 剤、金属キレート化オキシノイド化合物、スチリルベン ゼン系化合物等を挙げることができる。その代表例とし ては、2、5ーピス(5、7ージーtーペンチルー2ー ベンゾオキサゾリル)-1、3、4-チアジアゾール、 4、4'ーピス(5、7ーベンチルー2ーベンゾオキサ ゾリル)スチルベン、4、4'ーピス[5、7ージー (2-メチル-2-プチル) -2-ベンゾオキサゾリ ル]スチルベン、2、5-ビス(5、7-ジ-t-ベン チルー2-ベンゾオキサゾリル)チオフィン、2、5-ビス([5-α、α-ジメチルベンジル]-2-ベンゾ オキサゾリル)チオフェン、2、5-ビス[5、7-ジ - (2-メチル-2-ブチル)-2-ベンゾオキサゾリ ル] -3、4-ジヒェニルチオフェン、2、5、-ビス (5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル) チオフェン、 4、4'ーピス(2-ベンゾオキサイゾリル)ピフェニ ル、5-メチル-2-[2-[4-(5-メチル-2-ベンゾオキサイゾリル)フェニル] ビニル] ベンゾオキ サイゾリル、2-[2-(4-クロロフェニル)ピニ ル] ナフト [1、2-d] オキサゾールなどのベンゾオ キサゾール系、2、2'-(p-フェニレンジピニレ ン) -ピスペンゾチアゾールなどのベンゾチアゾールな どのベンゾチアゾール系、2- [2- [4- (2-ベン ゾイミダゾリル)フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾー ル、2-[2-(4-カルボキシフェニル)ビニル]ベ ンゾイミダゾールなどのベンゾイミダゾール系などの蛍 光増白剤が挙げられる。前記金属キレート化オキシノイ 40 ドの例としては、トリス(8-キノリノール)アルミニ ウム、ピス(8-キノリノール)マグネシウム、ピス (ベンゾ[f]-8-キノリノール) 亜鉛、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウムオキシド、 トリス(8-キノリノール)インジウム、トリス(5-メチル-8-キノリノール)アルミニウム、8-キノリ ノールリチウム、トリス(5-クロロ-8-キノリノー ル) ガリウム、ピス (5-クロロ-8-キノリノール) カルシウム、ポリ [亜鉛(II) ーピス(8-ヒドロキ シー5-キノリノニル)メタン]などの8-ヒドロキシ

挙げられる。スチリルベンゼン系化合物としては、1、 4-ピス(2-メチルスチリル)ベンゼン、1、4-(3-メチルスチリル) ベンゼン、1、4-ビス(2-メチルスチリル) ベンゼン、1、4-(3-メチルスチ リル) ベンゼン、1、4-ピス-(4-メチルスチリ ル) ベンゼン、ジスチリルベンゼン、1、4-ビス(2 -エチルスチリル)ベンゼン、1、4-ビス(3-エチ ルスチリル) ベンゼン、1、4-ビス(2-メチルスチ リル)2-メチルベンゼン等が挙げられる。

【0022】また、ジスチルピラジン誘導体も発光層に 10 用いられ、その代表例としては、2、5-ビス(4-メ チルスチリル) ピラジン、2、5-ピス(4-エチルス チリル) ピラジン、2、5-ピス[2-(1-ナフチ ル) ビニル] ピラジン、2、5-ビス(4-メトキシス チリル) ピラジン、2、5-ピス[2-(4-ピフェニ ル) ピニル] ピラジン、2、5-ピス「2-(1-ピレ ニル) ビニル] ピラジン等が挙げられる。さらに、ナフ タルイミド誘導体、ペリレン誘導体、オキサジアゾール 誘導体、アルダジン誘導体、シクロペンタジエン誘導 体、スチリルアミン誘導体、あるいはクマリン系誘導 体、芳香族ジメチリディン誘導体さらに特開平4-13 2189号公報によれば、発光層としてアントラセン、 サリチル酸塩、ピレン、コロネン等も挙げられる。

【0023】陰極層15の材料としては仕事関数の低い 金属もしくは合金が用いられ、Al、In、Mg、T i、Mg/Ag合金、Al/Li合金等が用いられる。 また、その成膜方法についても特に制限するものではな く、本実施の形態で示した抵抗加熱蒸着法以外にも、イ オンビームスパッタ法、マグネトロンスパッタ法、電子 ビーム蒸着法等の他の方法であったとしても成膜中に有 30 機材料の耐熱温度を超えるまで温度が上昇しなければど のような成膜方法であっても良い。さらに素子外表面上 に蒸着法やスパッタリング、塗布法等により大気中の酸 素や水分の影響を遮断するための保護膜を設ける場合も ある。その材料としては、GeO、SiO、SiO、、 Al,O₃、等の無機酸化物、熱硬化性、光硬化性の樹脂 や封止硬化のあるシラン系の高分子材料等が挙げられ る。

【0024】保持金具5は有機EL素子形成及び封止の 一連の製造工程において、ITO基板を固定可能な構造 であればよく、例えばクランプ機構を有するものが挙げ られる。封止材移動機構8は真空チャンバー1内に配設 された支持部8 a と、前記支持部8 a 移動停止自在に支 持され上部に封止材載置部を備えた封止材移動部8 bと を備えたもので、例えば水平方向の直動機構により封止 材移動部8 bを移動させることができる。接着剤硬化装 置9は真空チャンバー1の天井部に配設された高圧水銀 灯等の紫外線照射装置や、YAGレーザ、赤外線ランプ 等加熱装置等が挙げられる。基板搬送押圧機構10は前 記封止材移動部8 bと直交方向に移動し加圧できるもの 50

であればよく、例えばボールネジ等を用いた直動機構等 が挙げられる。

【0025】次に、本実施の形態による有機EL素子の 封止方法について説明する。図3(a), (b),

(c) は本発明の一実施の形態における有機EL素子の 形成工程から封止工程までの各工程を示した模式図であ る。図3(a)は真空チャンバー中で有機EL素子を形 成する工程図である。保持金具5に保持させたITO基 板3上に有機EL素子部4を形成する。尚、正孔輸送層 の形成から陰極の形成までは同一真空チャンバー中で行 ったが、素子形成時に素子が大気にさらされることがな ければ各層を別々の真空チャンパー中で形成しても良

【0026】図3(b)は連続した一連の真空チャンバ 一中で有機EL素子の構成部分と、接着部を有する封止 材とを対向するように配置する工程図である。真空チャ ンバー1内の真空度は特に制限するものではないが有機 EL素子部4への水分の侵入を抑えるためには10⁻¹T orr以下の減圧下で行うのが好ましい。まず、封止材 6を封止材移動機構8により移動させる。具体的な配置 については特に制限するものではないが、接着の容易 性、接着剤の垂れ防止等の点から図3(b)のように有 機EL素子部4の下部に封止材6を配置するのが好まし い。本発明に用いられる封止材6としては外部からの水 分や酸素の侵入が少ない材料であれば特に限定されるも のではなく、例えばガラス、液晶性ポリマー、高分子フ ィルム、金属等が挙げられる。さらに封止材6の形状に ついても特に限定するものではなく、例えば平面状のも のや、図3(b)に示すように封止材に凹凸を設け、有 機EL素子部4と封止材6とが接触することを防ぐこと のできるような形状を挙げることができる。また、接着 剤としては外部からの水分や酸素の侵入が少ない材料で あれば特に限定されるものではなく、例えば光硬化性樹 脂、低融点ガラス、エポキシ樹脂、液晶性ポリマー等が 挙げられる。中でも、透湿性が低く接着時間が早いとい う理由から光硬化性樹脂、低融点ガラスが好ましい。

【0027】光硬化性樹脂としては、カチオン硬化型、 ラジカル硬化型等が知られているが、本発明において最 も好ましく用いられるものはカチオン硬化型である。

【0028】図3(c)は一連の真空チャンパー内で I T〇基板と封止材とを接着する工程である。ITO基板 3若しくは封止材6の少なくとも1つを基板搬送押圧機 構10により移動させ、ITO基板3と封止材6の接着 部とを密着し押圧させる。尚、本実施の形態では、IT 〇基板の移動を直動機構で行ったが、移動機構について は特に制限するものではなく、ITO基板と封止材とを 搬送押圧できるものであればどのような機構であっても 良い。次に密着押圧後、接着剤硬化装置9によりITO 基板3と封止材6とを接着する。このようにして有機E L素子を封止した後、真空チャンバーを常圧に戻し素子

[0036]

を取り出す。なお本実施の形態では真空中において封止する場合についてのみ示したが、有機EL素子の形成工程から封止工程までの間、有機EL素子が大気に触れることがなければどのような方法であってもよく、例えば真空チャンバー中に不活性ガスを導入した後素子封止を行う方法等が挙げられる。この場合の不活性ガスは水分を含有しないことが必要であり、例えば低露点のAr、He、Ne、N₂、等が挙げられる。中でも、露点-80℃以下のものが好ましい。

【0029】次に、本発明の実施例について説明する。 【0030】

【実施例】

(実施例1)まず、実施の形態1で示したように有機E L素子を形成した。有機層の蒸着速度は5/sで行っ た。さらに有機EL素子上部に抵抗加熱法により酸化ゲ ルマニウム(Ge〇)を5000Å蒸着し、保護膜を形 成した。なお、ガラス基板は4cm×4cmのものを使 用し、その中央部に1cm²の有機EL素子を形成し た。次に、同一真空チャンバー中に予め準備しておいた 封止材を素子下部に移動させる。封止材としてはHOY A製の1mm厚の白板ガラスを用い、有機EL素子の構 成部分と対向する2.5 cm²の部分はサンドプラスト 法により0.3mmくり貫いた。これにより、封止材が 有機EL素子に接触して素子を破壊することを防ぐこと ができる。なお、サンドプラスト法の変わりにホーニン グ法を用いても良い。また、この封止材には接着剤とし て予め紫外線硬化型接着剤(大日本インキ社製 DEF ENSA OP-48) を約10 μm塗布しておいた。 膜厚については特に制限するものではないが、3~10 00μmが好ましい。続いて、基板搬送押圧機構により 30 素子の保持金具を下げITO基板と封止材とを重ね合わ せた。

【0031】ここで、接着剤である光硬化性樹脂は、封止までの間真空チャンバー中で脱泡されているため樹脂層の内部に気泡が残ることは少ないが、これをより確実なものとするためにITO基板側、封止材側の両面から基板搬送押圧機構を用いて4kgf/cm²で加圧し気泡を追い出した。次に、接着剤硬化装置として高圧水銀ランプを用い、真空チャンバー上部より紫外線を照射し光硬化性樹脂を硬化させた。この時、有機EL素子に紫40外線が照射されるのを防ぐため、有機EL素子形成工程の初期から接着部以外の部分には金属マスクを被覆した。以上のようにして、有機EL素子の形成工程から封止工程までを真空中で連続して行った有機EL素子を作製し、これをサンプル1とした。

【0032】 (実施例2) 実施例1 において光硬化性樹脂をイオン重合タイプ (協立化学産業 (株) 製W/R X C A - 0 1) に代えて、同様に有機E L 素子を作製した。これをサンプル2 とした。

【0033】 (実施例3) 実施例1, 2と同様にして、

有機EL素子及び保護膜の形成、さらに光硬化性樹脂を塗布した封止材の移動を行った。次に、リークバルブより真空チャンパー中にN,ガスを導入し常圧まで戻した。このN,ガスには、液体窒素トラップを通して極微量な水分まで取り除き純度99.9999%以上、露点-80℃以下としたものを使用した。以下、実施例1で示したものと同様な方法で封止材の接着を行うことで、素子表面に水を吸着させることなく封止までを終えることができ、かつ封止素子内部を不活性ガスで充満させることができた。これをサンプル3とした。

【0034】(比較例)実施例1,2及び3で示した本発明による有機EL素子の封止効果を確認するため、保護膜まで形成した後真空チャンバーから取り出し、続いてN.雰囲気中で封止を行った有機EL素子を作製した。この従来法による比較例の有機EL素子は、素子形成後一度大気中に取り出した以外は材料、構成、成膜条件等全て同じとした。これをサンプル4とした。

【0035】次に、実施例1、2及び3と比較例で得られた有機EL素子を用いてダークスポットの成長を比較した。試験はこれら4つの素子を40℃90%の同一環境チャンパー中に保存し、ダークスポットの成長を観察した。図4に各素子の保存時間とダークスポットの大きさとの関係を示す。この図4より明らかなように、素子形成から封止までを大気に触れることなく行った本実施例1、2及び3の有機EL素子は、比較例の素子形成後一度大気に曝された後封止したものに比べダークスポットの成長が大幅に抑えられていることがわかった。

【発明の効果】以上のように本発明の有機EL素子の封 止方法によって、有機材料、電極材の劣化を招く水分の 吸着及び進入を完全に防止し、長寿命化が可能な信頼性 の高い有機EL素子を得ることができる。

【0037】本発明の請求項1に記載の有機EL素子の製造方法によれば、有機EL素子の形成工程から封止材による封止工程までの工程を大気に曝すことなく行うこととしたものであり、これによりEL素子部への水分や酸素の吸着及び接触を完全に抑えることができ、有機材料、電極材の劣化を招く水分の吸着及び進入を完全に防止し、長寿命化が可能な信頼性の高い高品質の有機EL素子を得ることができる。

【0038】本発明の請求項2に記載の有機EL素子の製造方法は、請求項1において、前記有機EL素子の形成工程から封止材による封止工程までを1×10⁻¹Torrの1×10⁻¹Torrがましくは1×10⁻¹Torrの真空装置下で行うこととしたものであり、これによりEL素子部への水分や酸素工程の吸着及び接触を完全に抑えることができ、有機材料、電極材の劣化を招く水分の吸着及び進入を完全に防止し、長寿命化が可能な信頼性の高い高品質の有機EL表子を得ることができる。

11

【0039】本発明の請求項3に記載の有機EL素子の製造方法は、請求項1又は2において、透明または半透明の基板と封止材の少なくとも一部分を光硬化性樹脂によって接着する接着工程を有することとしたものであり、これにより、光硬化性樹脂の高耐湿性により外部からの水分や酸素を完全に遮断することができ、有機材料、電極材の劣化を招く水分の吸着及び進入を完全に防止し、長寿命化が可能な信頼性の高い高品質の有機EL素子を得ることができる。また、接着時間を短くすることができるので有機EL素子の生産性を高めることがで10

【0040】本発明の請求項4に記載の有機EL素子の製造装置は、真空チャンパーと、前記真空チャンパーに接続された真空装置と、前記真空チャパー内に配設された有機EL素子若しくは封止剤のいずれかを搬送し前記有機EL素子及び封止材を押圧する搬送押圧手段及び前記有機EL素子と前記封止材の間に形成された接着剤層を硬化させる硬化手段と、を有することとしたものであり、これにより、有機EL素子の製造装置内で簡便に有機EL素子基板と封止材とを接着することができ、高い20生産性で極めて高品質の有機EL素子を低原価で量産できる

【0041】本発明の請求項5に記載の有機EL素子の製造方法は、請求項4において、前記硬化手段が紫外線照射装置であることとしたものであり、これにより、有機EL素子の製造装置内で簡便に有機EL素子基板と封止材とを接着することができ、高い生産性で極めて高品質の有機EL素子を低原価で量産できる。また、硬化時の熱による劣化がなく、信頼性の高い有機EL素子を高い生産性で量産することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態における有機EL素子の

製造装置の断面模式図

【図2】本発明の一実施の形態における有機EL素子の 断面模式図

【図3】(a)は真空チャンバー中で有機EL素子を形成する工程図

(b) は連続した一連の真空チャンバー中で有機EL素子の構成部分と、接着部を有する封止材とを対向するように配置する工程図

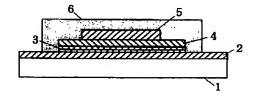
(c) は一連の真空チャンパー内で I T O 基板と封止材 とを接着する工程図

【図4】本発明の一実施の形態における有機EL素子と 従来素子のダークスポット成長を比較した図

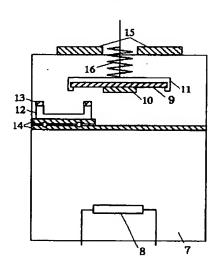
【図5】一般的な有機EL素子の要部断面図 【符号の説明】

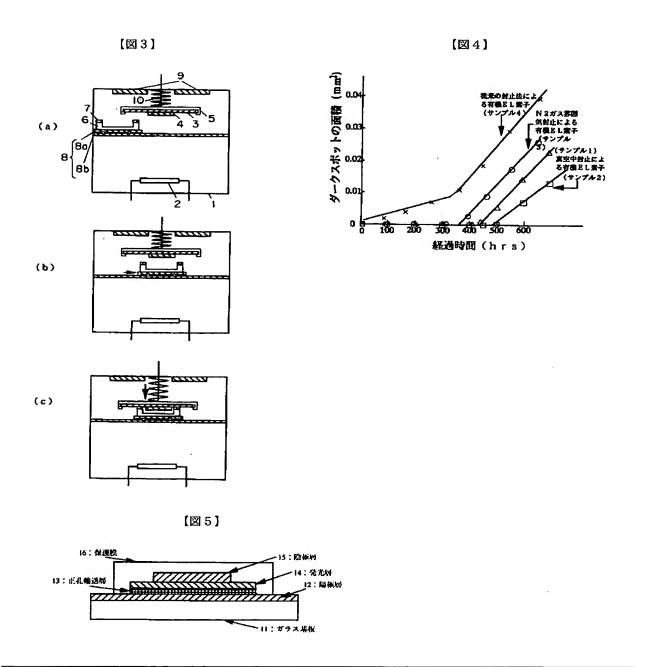
- 1 真空チャンパー
- 2 蒸着源
- 3 ITO基板
- 4 有機EL素子部
- 5 保持金具
- 6 封止材
 - 7 接着部
 - 8 封止材移動機構
 - 8 a 支持部
 - 8 b 封止材移動部
 - 9 接着剤硬化装置
 - 10 基板搬送押圧機構
 - 11 ガラス基板
 - 12 陽極層
 - 13 正孔輸送層
- 30 14 発光層
 - 15 陰極層
 - 16 保護膜

【図1】



[図2]





フロントページの続き

(72)発明者 原 慎太郎 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内